



Cadence Design Systems, Inc.

ケイデンスは、人々の生活や仕事を一変させるような革新的な電子製品の設計を支援しています。弊社はSystem Design Enablement (SDE) 戦略の下、半導体ベンダーやシステムベンダーのお客様に対して、航空宇宙、自動車、クラウドデータセンター、コンシューマ、インダストリー、IoT (モノのインターネット)、モバイルなど各市場セグメントに向けて高度に差別化された製品の開発に必要なソリューションを提供します。チップ設計、パッケージ設計、ボード設計、システム設計をサポートする最先端の電子設計自動化 (EDA) ソフトウェアおよびハードウェア、さらに設計IP、検証IPを提供します。

効率的で迅速なチップ設計

カスタム設計、アナログ設計、RF設計、ミックスシグナル設計開発において、設計者が使うツールを提供するリーダーとして、シリコン作成前の設計、検証の様々な段階で迅速かつ正確に設計コンセプトの入力を可能にする完全なフローを提供します。

カスタムIC設計の中でそれほどクリティカルでない部分の設計については、できるだけ自動化し、エンジニアは高精度の設計調整や回路の性能向上が必要な重要な部分に専念できるようになります。

弊社はここ数年間、チップのデジタル部分の設計に対して、一層の生産性向上と設計プロセスの高速化をもたらす全く新しい次世代ツール群を発表してきました。

ケイデンスのIPポートフォリオには、チップ設計に迅速に統合できるカスタマイズ可能なブロックが含まれており、設計チームはこれらの部分について再設計から解放されます。

このポートフォリオには、ビジョン、オーディオ、IoT (モノのインターネット)、ベースバンドアプリケーション向けのTensilica® DSP、Denali®メモリおよびストレージIP、PCI Express®、USBおよびイーサネットなどの最新の標準インターフェース向けのコントローラが含まれています。

また、インターフェース規格やメモリ規格を検証するための検証IPも提供しています。

Cadence® Verification Suiteは、シリコン実装前にチップ設計を迅速に検証するために、設計サイクルの全ステップにおける検証を高速化する4つのコアプラットフォームを提供します。ソフトウェアベースの検証ソリューションとハードウェア検証アクセラレータの組み合わせにより、最短の検証時間と高品質の予測可能性を実現します。

会社情報

設立	1988
本社所在地	2655 Seely Ave. San Jose, CA 95134 USA
ウェブサイト	www.cadence.com
NASDAQ銘柄コード	CDNS
事業内容	EDAソフトウェア、ハードウェア、IP、および関連サービス

ICパッケージ設計

今日の半導体パッケージにおいては、複雑性と性能要件が増大し続けていますが、設計リソースに関しては、ほとんどの組織で変化がなく、効率と生産性の向上が一層求められています。ケイデンスのパッケージングとマルチファブリックのコ・デザインツールがもたらす自動化と高い精度により、全設計プロセスを迅速に進めることができます。

PCB設計

ケイデンスが提供する最先端のPCBレイアウトと配線テクノロジーは、一般の開発者から非常に革新的な新製品を開発する設計者に至るまで幅広く使われています。

ケイデンスのツールは、単純な電子的解析からマルチギガビット幅をサポートするマルチボードシグナル・シミュレーションまで、様々な場面で設計者を支援します。

システム設計

ケイデンスのシステム開発ツールおよび機能検証ツールは、お客様がアプリケーション開発向けにハードウェア/ソフトウェアシステムを迅速に完成するのを支援し、複雑なシステム設計作業を扱うソフトウェアツールやハードウェア開発支援システムを提供します。

サービス

ケイデンスのサービスは、メソドロジーとテクノロジーの採用、シリコンの利用、人材開発の分野でお客様をサポートし、生産性を向上するとともにリスクを削減します。

A Great Place to Work



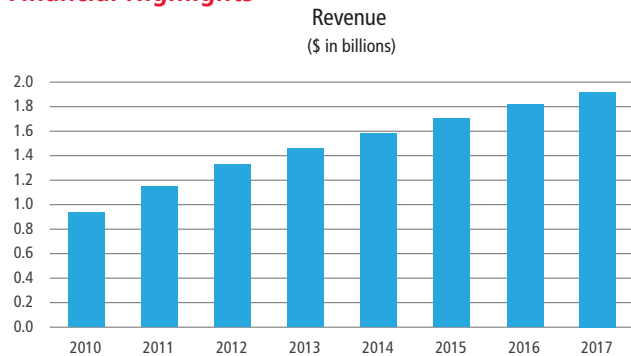
ケイデンスの「One Cadence – One Team」という企業文化によって、市場や業界をリードする革新やビジネスの成功を実現しています。

ケイデンスは世界中で「働きたい職場」として認知されており、過去3年間でFortune誌の「働きたい企業トップ100」に選ばれています。

さらに、アジア系アメリカ人、地域奉仕活動に参加したい人、ベビー・ブーム世代の人、大学新卒者、子育て中の人にとって「最も働きたい職場」として認知されています。

「働きたい職場」のリストは、会社経営陣への信頼度、仕事に対するプライド、同僚に対する仲間意識など、職場文化のさまざまな側面に関する労働者の評価に基づいて作成されています。

Financial Highlights



エグゼクティブ・マネージメント

Lip-Bu Tan

Chief Executive Officer

Anirudh Devgan, Ph.D.

President

Tom Beckley

Senior Vice President and General Manager, Custom IC & PCB Group

Jim Cowie

Senior Vice President, General Counsel and Secretary

Tina Jones

Senior Vice President, Global Human Resources

Neil Kole

Senior Vice President and Chief Information Officer

Babu Mandava

Senior Vice President and General Manager, IP Group

Nimish Modi

Senior Vice President, Marketing & Business Development

John Wall

Senior Vice President and Chief Financial Officer, Digital & Signoff Group

Chin-Chi Teng, PhD

Senior Vice President and General Manager, Digital & Signoff Group

Neil Zaman

Senior Vice President, Worldwide Field Operations

日本ケイデンス・デザイン・システムズ社 会社概要

会社名: 日本ケイデンス・デザイン・システムズ社
Cadence Design Systems, Japan

商号: ケイデンス・デザイン・システムズ (ジャパン) ビー・ヴィ

所在地: 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-100-45
TEL: 045-475-2221 (代) FAX: 045-475-2451
URL: <https://www.cadence.com/jp>
(関西営業所)
〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町2-6-12
サンマリオンNBF タワー16F
TEL: 06-6121-8095 FAX: 06-6121-7510

社長: 金子 敏文 (Toshifumi Kaneko)

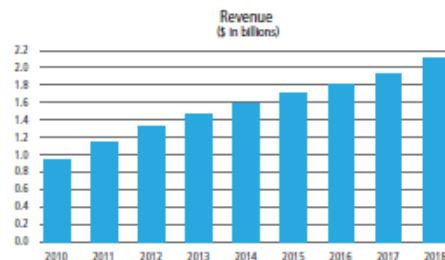
設立: 1997年3月 (1989年4月日本での業務開始)

資本金: 3,745,955 ユーロ

従業員数: 200名

事業内容: 米国ケイデンス社の電子設計ツールの開発、販売、およびサポートと設計支援サービス

販売代理店: イノテック株式会社



cadence[®]

日本ケイデンス・デザイン・システムズ社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-100-45
TEL: 045-475-2221 (代)

www.cadence.com/jp

© 2017 Cadence Design Systems, Inc. All rights reserved worldwide. www.cadence.com/go/trademarksに掲載されているCadence, Cadenceロゴおよびその他のCadenceマークはCadence Design Systems, Inc.の商標または登録商標です。PCI ExpressとPCIeはPCI-SIGの登録商標です。その他記載されている製品名および会社名は各社の商標または登録商標です。 . 9333 0817 SA/JT/PDF